# **DEVELOPMENT OF C-BAND INTEGRATED WAVEGUDE CIRCUIT**

Atsushi. Miura<sup>1,A)</sup>, Kibatsu. Shinohara<sup>A)</sup>, Tsumoru, Shintake<sup>B)</sup>, Takahiro, Inagaki<sup>B)</sup>, Katsutoshi, Shirasawa<sup>B)</sup>

A) NIhon Kosyuha Co.LTD
1119 Nakayama, Midori-ku, Yokohama-city, Japan 226-0011
<sup>B)</sup> RIKEN Harima institute SPring-8
1-1-1 Koto, Hyogo, Japan 679-5148

#### Abstract

Compact C-band integrated waveguide circuits composed of 3dB-hybride, 2-directional couplers and 2-vacuum port, have been developed for the SCSS XFEL project at RIKEN/Spring-8 Japan. This component is used for rf pulse compression system with input power of 50MW and output power of 200MW. Directional coupler is new designed by 2-coupled iris type at H-plane of waveguide with wide band 2-transformers from coaxial to waveguide, in order to get high stability of rf monitoring and high capability of rf power. 2-hot models were made and had good rf properties without any tunings. High power test was performed and reached complete results

# Cバンド集積型立体回路の開発

### 1.はじめに

理化学研究所 播磨研究所では高輝度XFEL源と してSCSS計画 (Spring-8 Compact SASE Source)を 推進している。SCSSでは全長800mのコンパクトなリ ニアック、真空封止アンジュレーターで波長1 Ľ 下のコヒーレントX線の発振を目指している。現在 試験加速器としてS,Cバンド250MeVのリニアック、 真空封止アンジュレーターを建設し50nmの軟X線の 発振試験を行い成功している。将来は6~8GeVの 400m程リニアックと80mのアンジュレーターを建設 する予定である<sup>[1]</sup>。SCSSではリニアックの電子ビー ムを高バンチ圧縮率で直接アンジュレーターに入射 するため、従来のリニアックに比べ高いビーム安定 度が要求される。加速電界について10<sup>-4</sup>、位相 について10<sup>-3</sup>rad(0.1度)が必要である。また 使用される数量の多さからメンテナンスの容易さ、 コンパクト化も必要である。集積型立体回路とは-つの銅ブロックに複数の立体回路を構成するもので、 コンパクト化、高安定化の手段として考えられた。 本稿ではRFパルス圧縮装置用の分配合成器である 3 d Bハイブリッド、入出力 R F モニター(方向性 結合器2台)、真空引き口導波管2台を集積した回 路を設計、製作、大電力試験を行ったので報告する。

#### 2.仕様と設計

表1・図1に集積型立体回路の仕様・構造を示す。 3 d Bハイブリッドは単品として既に製作・使用実 績もある<sup>[2]</sup>。方向性結合器と真空引き口は新設計を 行った。SCSSのRFモニターは従来より1桁以上高 い位相・振幅の測定精度が要求される。通常使用さ

表1:集積型立体回路の仕様

周波数	5712MHz ± 5MHz	
入力電力	50 MW peak (最大)	
出力電力	200 MW peak 以上	
RF パルス幅	5 µ S	
RF パルス繰り返し周波数	60ppS	
方向性結合器 結合度	60 ± 2 d B	
方向性結合器 方向性	25 dB以上(目標 30 d B)	
3dB ハイブリッド分配器 結合度	3 d B	
3dB ハイブリッド分配器 方向性	30 d B以上	

れるベーテホール型では反射位相により見かけ上の 方向性が変化したり、副線路特性の温度係数が高く、 温度制御しにくい欠点がある。これに変わるものと して H 面 2 開口型の方向性結合器を採用し、精度向 上を行った。方向性結合器副線路の両端に接続する 同軸導波管変換機の反射量は方向性に関わる重要な 特性である。このため広帯域で反射係数が低い方式 を採用する必要がある。同軸導波管変換機の方式は 各種あるが、3次元電磁界シュミレーションを行い、 最も広帯域でコンパクトな方式を採用した。この結 果、 E面1段でインピーダンス変換を行う方式と なった(図2参照)。シュミレーションで得られた 帯域幅はリターンロス30dB以下で±40MHz である。真空シールはN型コネクタ部で行うことに より従来のベーテホール型より耐電力の向上を得ら れた。さらに副導波管内を真空にすることにより真

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> E-mail: miura@nikoha.co.jp

空引き口を副線路側に設置でき、コンパクト化を実 現している。2開口型では結合度、方向性共に開口 の寸法のみで決定するので、ベーテホール型の様な 複雑な調整は不要でありコストダウンを実現するこ とができる。これは今後の量産化に向けて好都合で ある。



図1:Cバンド集積型立体回路の構造

## 3.低電力モデル

3 d Bハイブリッド部は既に実績があるため同軸導 波管変換機と2開口型方向性結合器の低電力モデル を製作し測定を行った。

### 3.1 同軸導波管変換機

図 2 に同軸導波管変換機の低電力モデルを示す。 一段目の高さ寸法H、ショート板の位置L、アンテナ の位置C(図2中H,L,Cと記した寸法)を変化させ VSWRの測定を行った。その結果シュミレーション値 H=11.09mm、L=29.52mm、C=5.95mmに対してVSWRが良 くなる実測値はH=11.09mm、L=29.92mm、C=6.75mmと なった。帯域幅はリターンロス30dB以下で±3 0 MHzであった。シュミレーション結果と異なっ た主な原因は、真空封止N型コネクタと同軸導波管 変換器の内軸接合部で発生する反射と考えられる。



#### 図2 同軸導波管変換機の低電力モデル

#### 3.2 方向性結合器

図3に方向性結合器の低電力モデルを示す。開口 スリットの幅Wとスリット間隔H(図3中W、Hと記し た寸法)を変化させ結合度、方向性を測定した。副 導波管の両端に構成されている同軸導波管変換機は 3.1項で最適化されたものと同じである。方向性が 最も良くなるHはg/4(15.7mm)に等しいことが わかった。これは結合度が60dBと小さいので理 論値に近いと考えられる。方向性としては30dB 以上得られることがわかった。結合度60dBを得 るための幅Wはシュミレーション値6.4mmに対して 6.2mmでも57.8dBであることがわかった。実機で は幅Wを外装し6.07mmとした。



図3 方向性結合器の低電力モデル

### 4.実機製作・低電力試験

写真1に製作した実機を示す。表2に低電力試験の結果を示す。実機は2台製作した。1台は仕様を満足したが、1台は入力側の方向性結合器の方向性が仕様に入らなかった。ボアスコープで内部を確認すると副導波管の1部にロー材が流れておらず接触不良を起こしていることがわかった。これは製造構造上の問題であり、製作方法を変えることで改善できることがわかった。仕様を満たさなかった1台については現在修正中である。



写真1 集積型立体回路実機

表2:集積型立体回路の低電力試験結果

周波数	5712MHz
	± 5MHz
入力VSWR	1.02
3dBハイブリッド分配器 結合度	3.06 d B
3dBハイブリッド分配器 方向性	40 d B以上
入力側 方向性結合器 進行波 結合度	58.3 d B
反射波 結合度	58.2 d B
進行波 方向性	29 d B
反射波 方向性	33 d B
出力側 方向性結合器 進行波 結合度	58.2 d B
反射波 結合度	58.1 d B
進行波方向性	27 d B
反射波 方向性	39 d B

# 5. 大電力試験

本装置を用いてパルスコンプレッションシステム を構築し、リニアックに実装して大電力試験を行っ た。図4に定常運転時の各波形を示す。RF入力 (CH2)は27MW、パルス幅2.5µsecで2.0µsec後 に位相反転を行っている。最大出力電力(CH3)は130 MWである。CH1はクライストロンカソード電圧で 300kVである。定常運転は特に問題無く、XFELの 発振に貢献した。パルスコンプレッションにはさら に大電力を入力した試験も行っており、本学会の発 表<sup>[3]</sup>を御参照下さい。



# 時波形(集積型立体回路の入出力モニタ信 号)

## 6.今後

集積型立体回路の設計、製作、大電力試験を行い 良好な結果が得られた。集積型立体回路としての今 後の課題は接触不良を発生させない製造方法の確立 である。また今回開発した、方向性結合器や真空引 き口の特性は優れているため、単品としても利用可 能である。

# 参考文献

- T. Shintake et. al, "STATUS OF SCSS X-FEL PROJECT AT RIKEN/SPRING-8", Proc. of the 30th linear accelerator meeting in Japan, July 2005, p. 14
- [2] 吉田光宏、"The Research and Development of High Power C-band RF Pulse Compression System using Thermally Stable High-Q Cavity", 2003年 東京大学博 士論文
- [3] K. Shirasawa et. al, "Operational Experience of C-band Accelerator at the SCSS Prototype Accelerator", 本 研究会、2006年

FP32